



Electronics for the Future

決算説明会 2023年度 上半期業績

2023年11月2日

ローム株式会社

代表取締役社長 松本 功

- **2023年度上半期 業績報告**
- **2023年度通期 修正発表計画**
- **設備投資の状況**
- **在庫の状況**
- **株主還元**
- **LSI事業の戦略**
- **パワーデバイス事業の戦略**
- **東芝非公開化への参画について**

2023年度 上半期 実績 (期初計画比、前年同期比)

(単位：億円)

	FY2023 上半期 実績	FY2023 上半期 期初計画	期初計画比	FY2022 上半期 実績	前年同期比
売上高	2,393	2,500	▲4.3%	2,599	▲7.9%
営業利益	298	330	▲9.6%	504	▲40.8%
(対売上比率)	(12.5%)	(13.2%)	-	(19.4%)	-
経常利益	500	335	+49.5%	709	▲29.4%
(対売上比率)	(20.9%)	(13.4%)	-	(27.3%)	-
純利益	373	280	+33.2%	521	▲28.4%
(対売上比率)	(15.6%)	(11.2%)	-	(20.1%)	-
EBITDA	613	675	▲9.2%	752	▲18.5%
(対売上比率)	(25.6%)	(27.0%)	-	(29.0%)	-

期中平均レート(¥/US\$)

(141.31円)

(130.50円)

(133.46円)

期末レート(¥/US\$)

(149.58円)

(130.00円)

(144.81円)

2023年度 上半期 市場別 売上の変動要因 (前年同期比)

(単位：億円)

上半期売上高

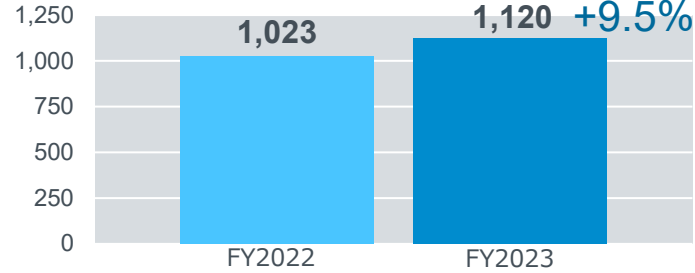
2,599億円

FY2022 上半期
実績

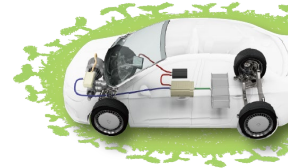
2,393億円
▲7.9%

FY2023 上半期
実績

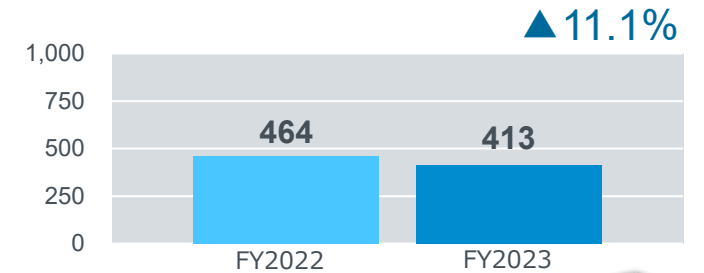
自動車



- インフォテインメント分野 ▲0
- ボディ分野 ▲+32
- パワートレイン分野 ▲+9
- 安全走行ADAS分野 ▲+7
- xEV分野 ▲+56
- その他 ▲+7



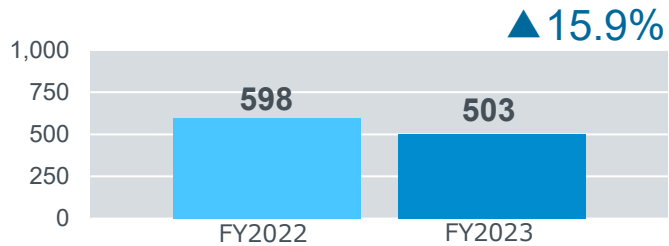
産機



- FA分野 ▲25
- エネルギー分野 ▲+15
- ホームビルディング分野 ▲5
- その他 ▲35



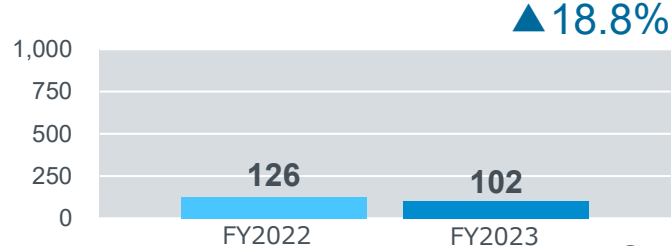
民生



- AV関連 ▲23
- 家電分野 ▲39
- その他 ▲32



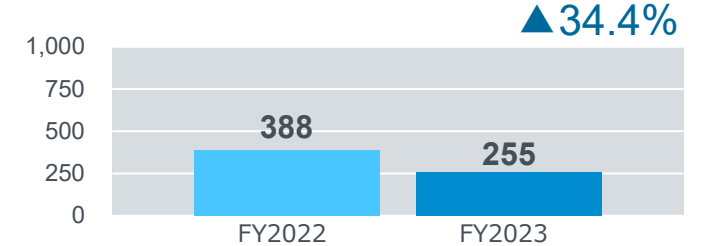
通信



- スマホ&モバイル分野 ▲24
- 基地局&インフラ分野 ▲+2
- 有線通信分野 ▲2



コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 ▲96
- 決裁端末向け ▲24
- 事務機分野 ▲14



※業種分類：現在の状態で集計

2023年度 上半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

上半期売上高

2,599億円

2,393億円

FY2022 上半期実績

FY2023 上半期実績

▲7.9%

海外売上高比率

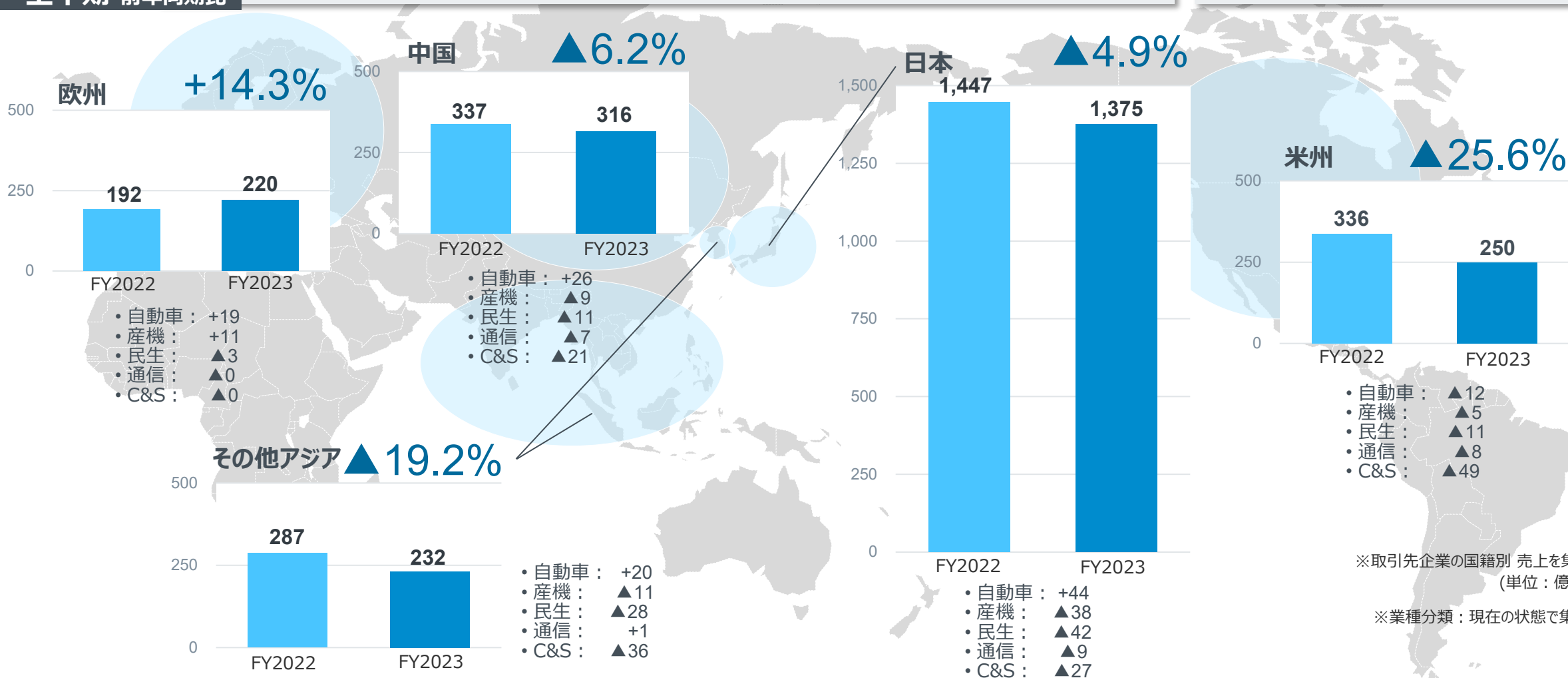
44.3%

FY2022 上半期

42.5%

FY2023 上半期

上半期 前年同期比



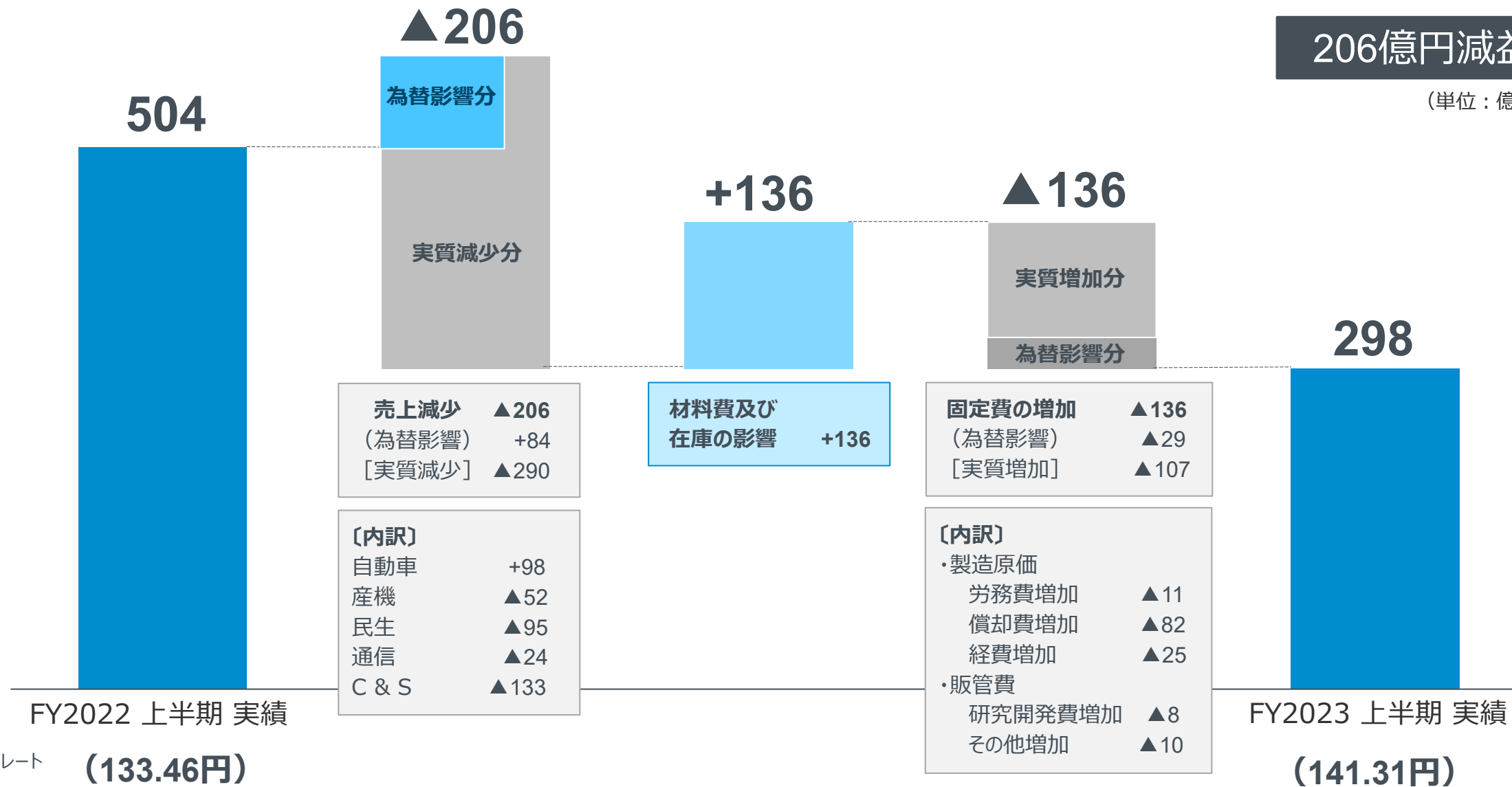
※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

2023年度 上半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)

206億円減益

(単位：億円)



期中平均レート (¥/US\$) **(133.46円)**

(141.31円)

2023年度 上半期 実績 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2023 上半期 実績	FY2022 上半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	1,073	1,170	▲97	▲8.3%
	セグメント利益	122	257	▲135	▲52.6%
	(利益率)	(11.4%)	(22.0%)	-	-
半導体素子	売上	1,020	1,095	▲75	▲6.8%
	セグメント利益	130	189	▲59	▲31.3%
	(利益率)	(12.7%)	(17.3%)	-	-
モジュール	売上	169	182	▲13	▲7.2%
	セグメント利益	19	28	▲9	▲32.0%
	(利益率)	(11.4%)	(15.6%)	-	-
その他	売上	129	151	▲22	▲14.2%
	セグメント利益	12	30	▲18	▲59.6%
	(利益率)	(9.6%)	(20.3%)	-	-

2023年度 通期 業績予想（期初計画比、前期比）

※今回 修正発表

（単位：億円）

	FY2023 修正計画	FY2023 期初計画	期初計画比	FY2022 実績	前期比
売上高	5,000	5,400	▲7.4%	5,078	▲1.6%
営業利益	530	750	▲29.3%	923	▲42.6%
（対売上比率）	(10.6%)	(13.9%)	-	(18.2%)	-
経常利益	700	870	▲19.5%	1,095	▲36.1%
（対売上比率）	(14.0%)	(16.1%)	-	(21.6%)	-
純利益	590	700	▲15.7%	803	▲26.6%
（対売上比率）	(11.8%)	(13.0%)	-	(15.8%)	-
EBITDA	1,314	1,590	▲17.4%	1,484	▲11.5%
（対売上比率）	(26.3%)	(29.4%)	-	(29.2%)	-

期中平均レート(¥/US\$)

(140.71円)

(130.27円)

(134.95円)

期末レート(¥/US\$)

(140.00円)

(130.00円)

(133.53円)

(単位：億円)

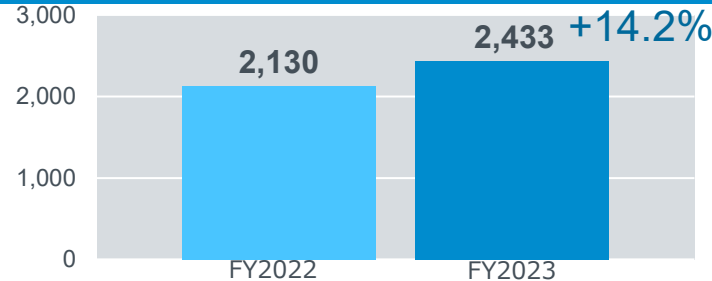
通期売上高

5,078億円 ▲1.6%
5,000億円

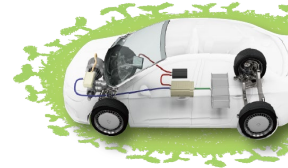
FY2022 通期
実績

FY2023 通期
修正計画

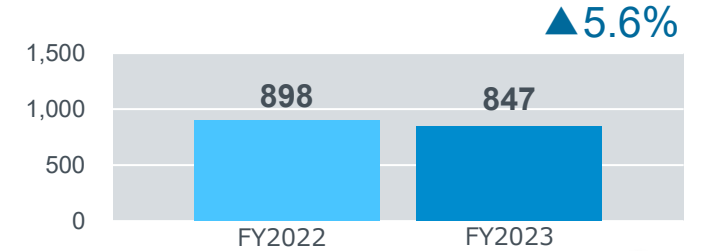
自動車



- インフォテインメント分野 ▲10
- ボディ分野 +83
- パワートレイン分野 +23
- 安全走行ADAS分野 +10
- xEV分野 +190
- その他 +7



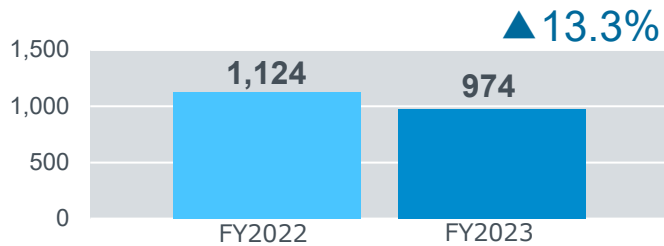
産機



- FA分野 ▲18
- エネルギー分野 +22
- ホームビルディング分野 ▲7
- その他 ▲47



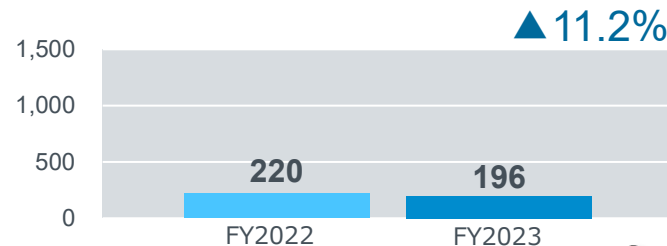
民生



- AV関連 ▲19
- 家電分野 ▲42
- その他 ▲88



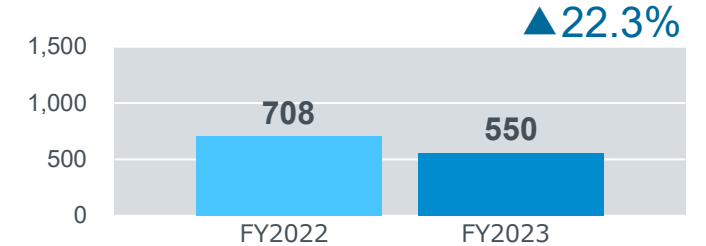
通信



- スマホ&モバイル分野 ▲25
- 基地局&インフラ分野 +0
- 有線通信分野 ▲0



コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 ▲94
- 決裁端末向け ▲28
- 事務機分野 ▲35



※業種分類：現在の状態で集計

2023年度 通期計画 国籍別 売上の変動要因 (前年比)

通期売上高

5,078億円

5,000億円

FY2022 通期実績

FY2023 通期修正計画

▲1.6%

海外売上高比率

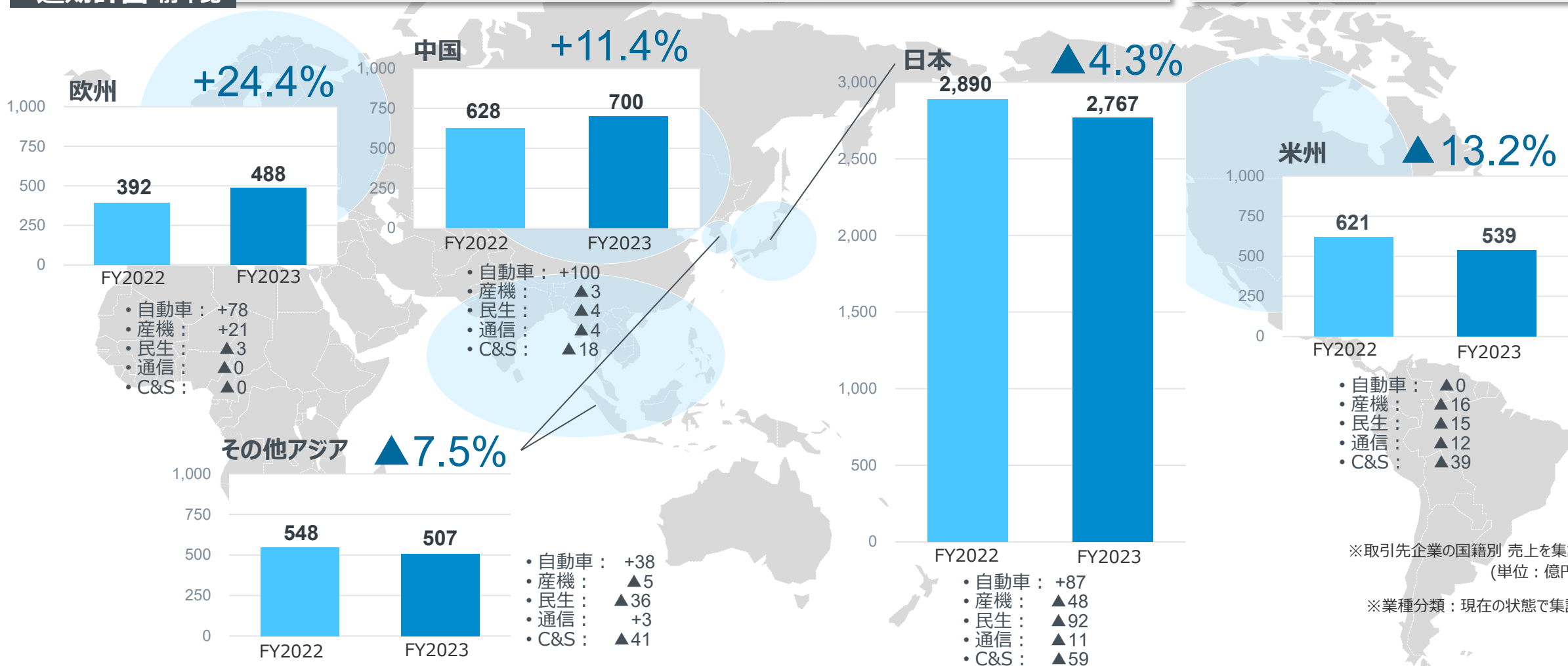
43.1%

FY2022 通期

44.7%

FY2023 通期

通期計画 前年比



※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

※業種分類: 現在の状態で集計

2023年度 通期計画 営業利益 増減分析 (前年比)

393億円減益

(単位：億円)

923



FY2022 通期 実績

(134.95円)

期中平均レート
(¥/US\$)

▲78



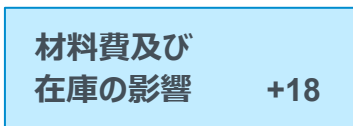
為替影響分

実質減少分

売上減少	▲78
(為替影響)	+144
[実質減少]	▲222

〔内訳〕	
自動車	+303
産機	▲50
民生	▲150
通信	▲25
C & S	▲157

+18



材料費及び
在庫の影響

+18

▲333



実質増加分

為替影響分

固定費の増加	▲333
(為替影響)	▲32
[実質増加]	▲301

〔内訳〕	
・製造原価	
労務費増加	▲19
償却費増加	▲217
経費増加	▲40
・販管費	
研究開発費増加	▲29
その他増加	▲28

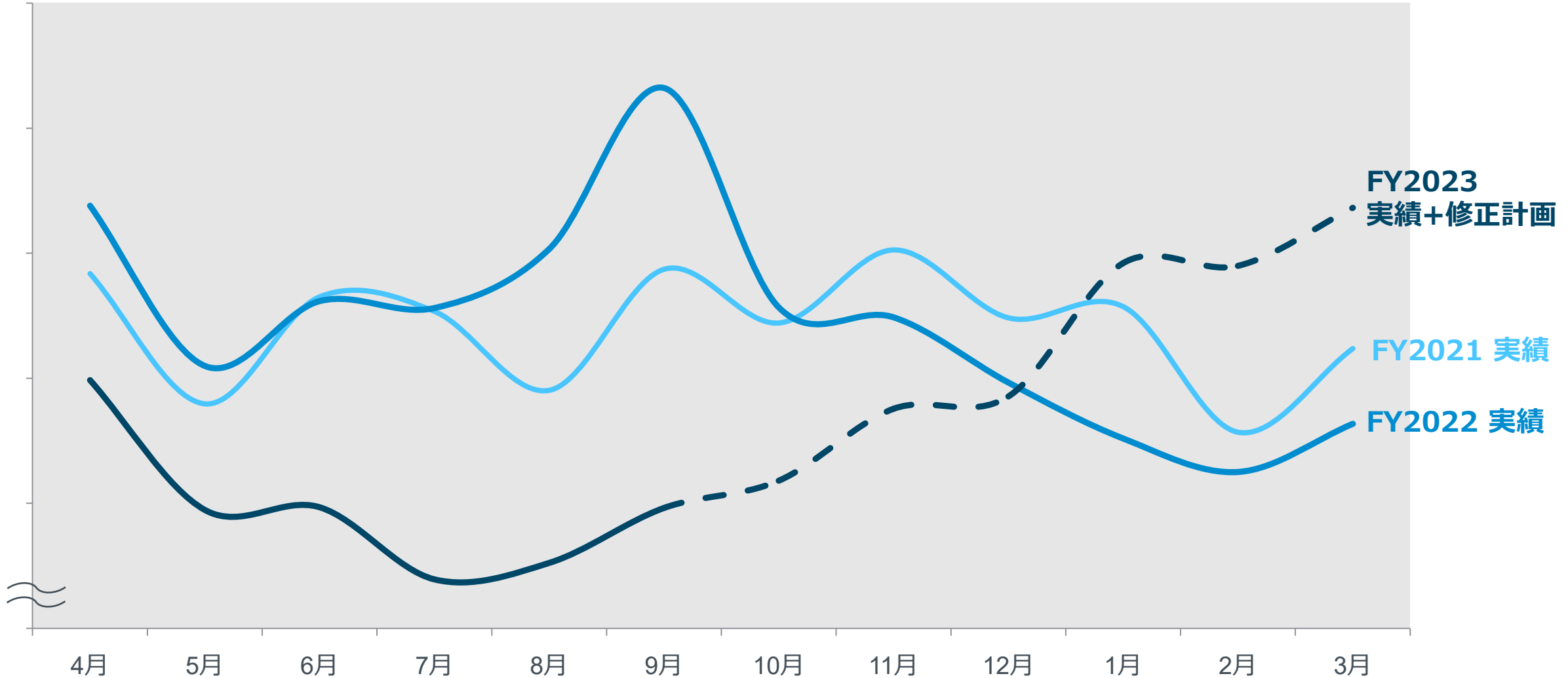
530



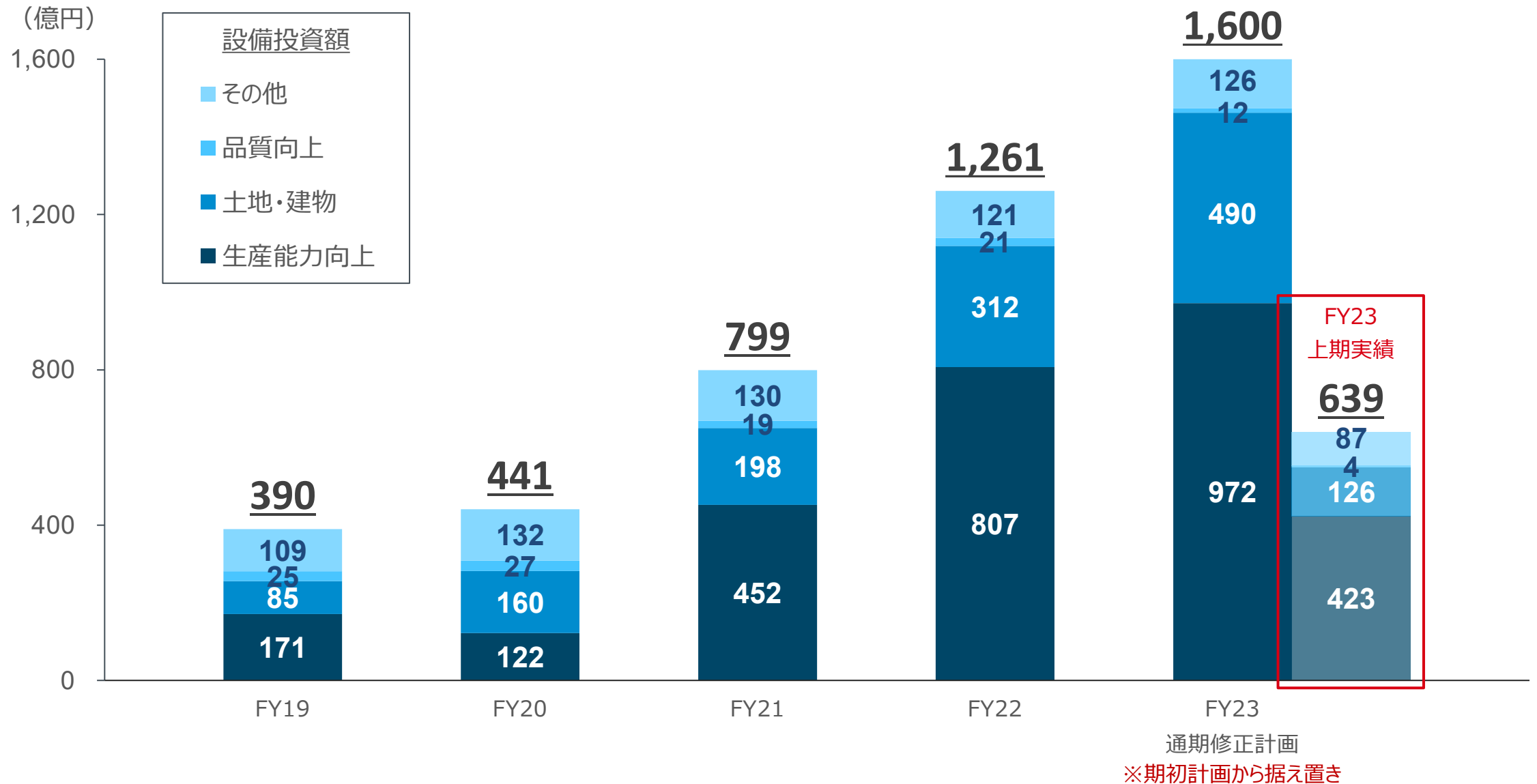
FY2023 通期 修正計画

(140.71円)

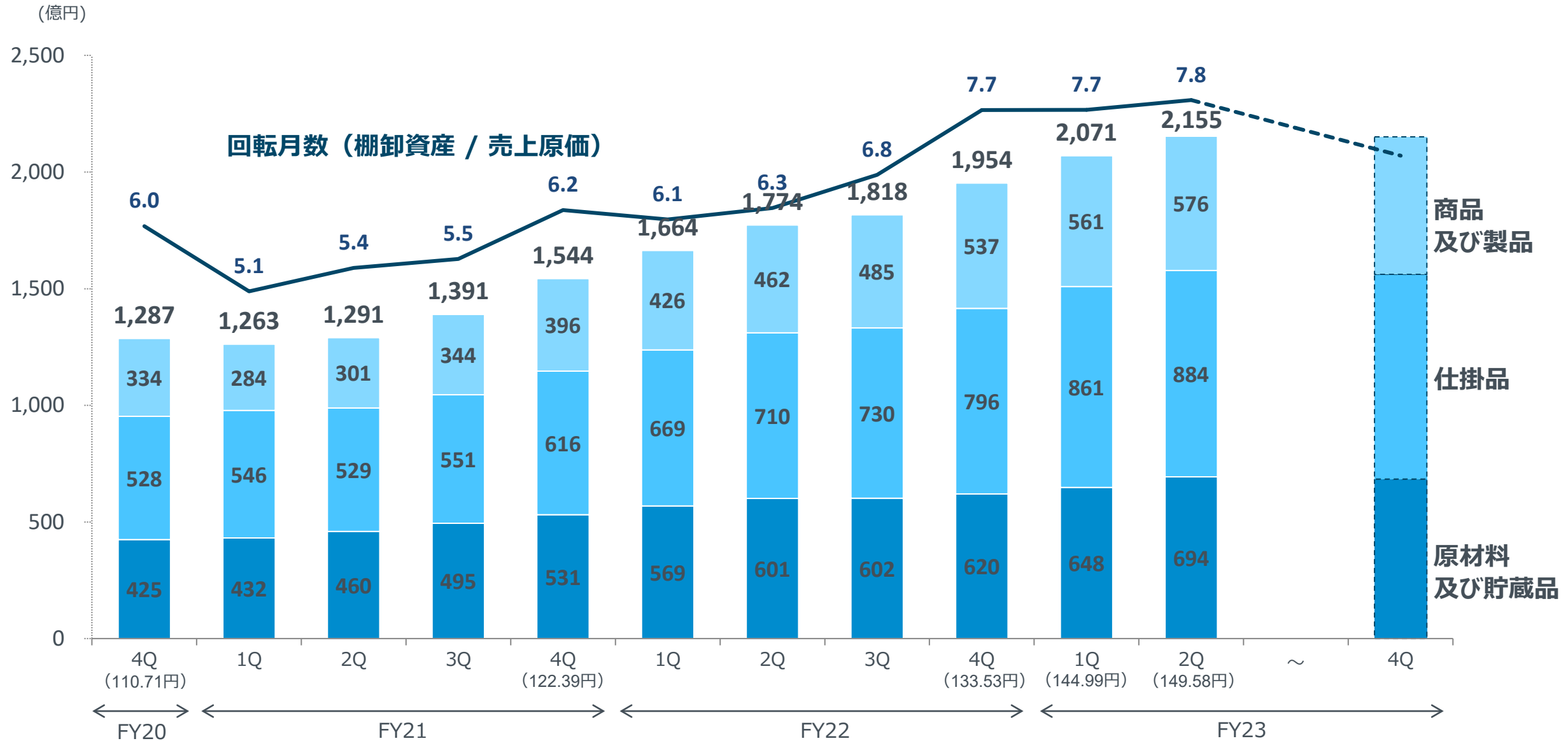
※為替は1USD = 105円で換算



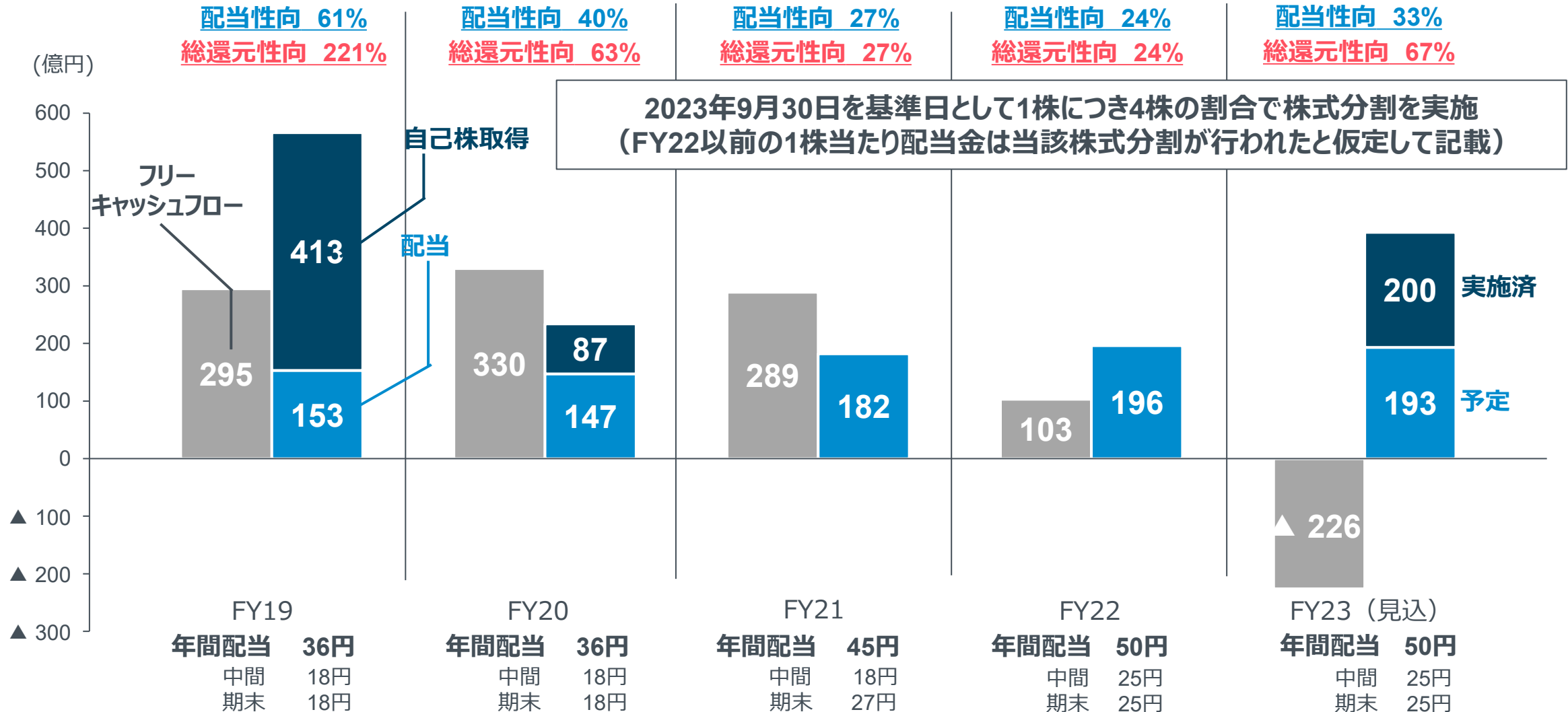
設備投資の状況



在庫の状況 (金額)



株主還元の推移



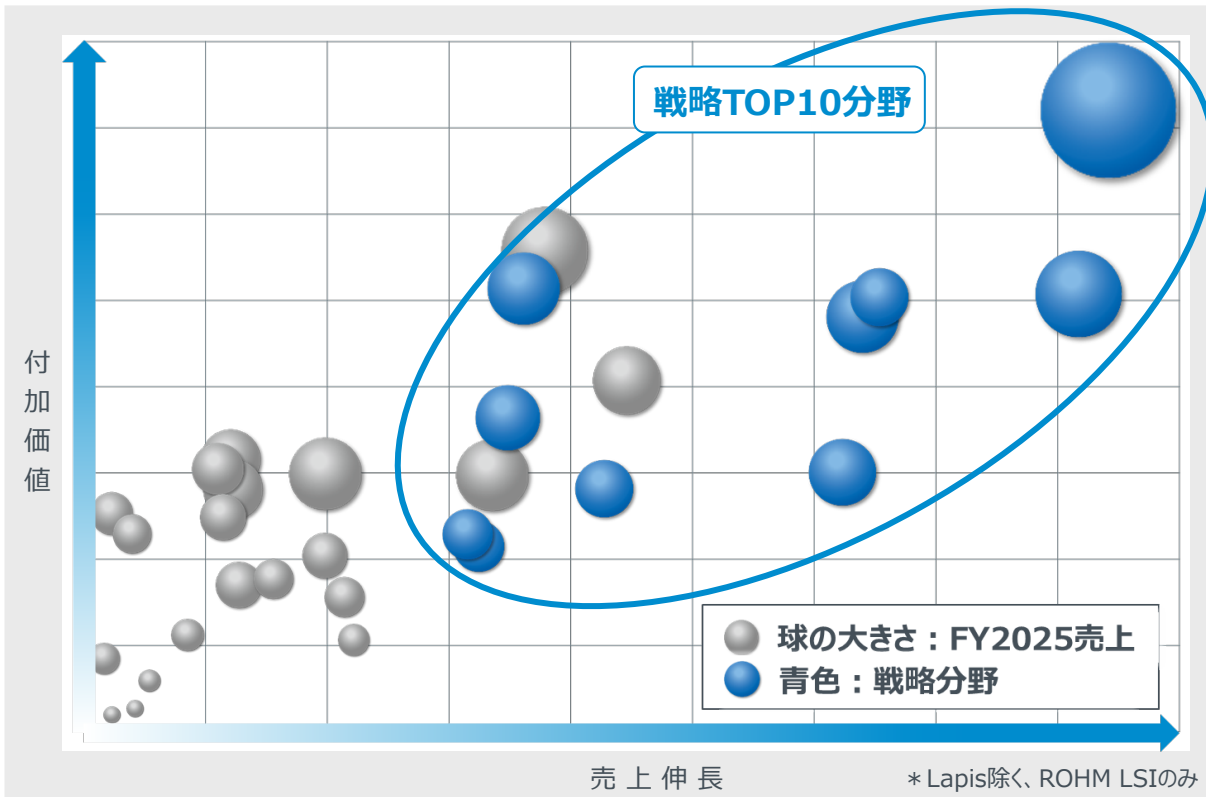
*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 - 設備投資

ASSP製品においては戦略TOP10分野を開発・サポート拡充

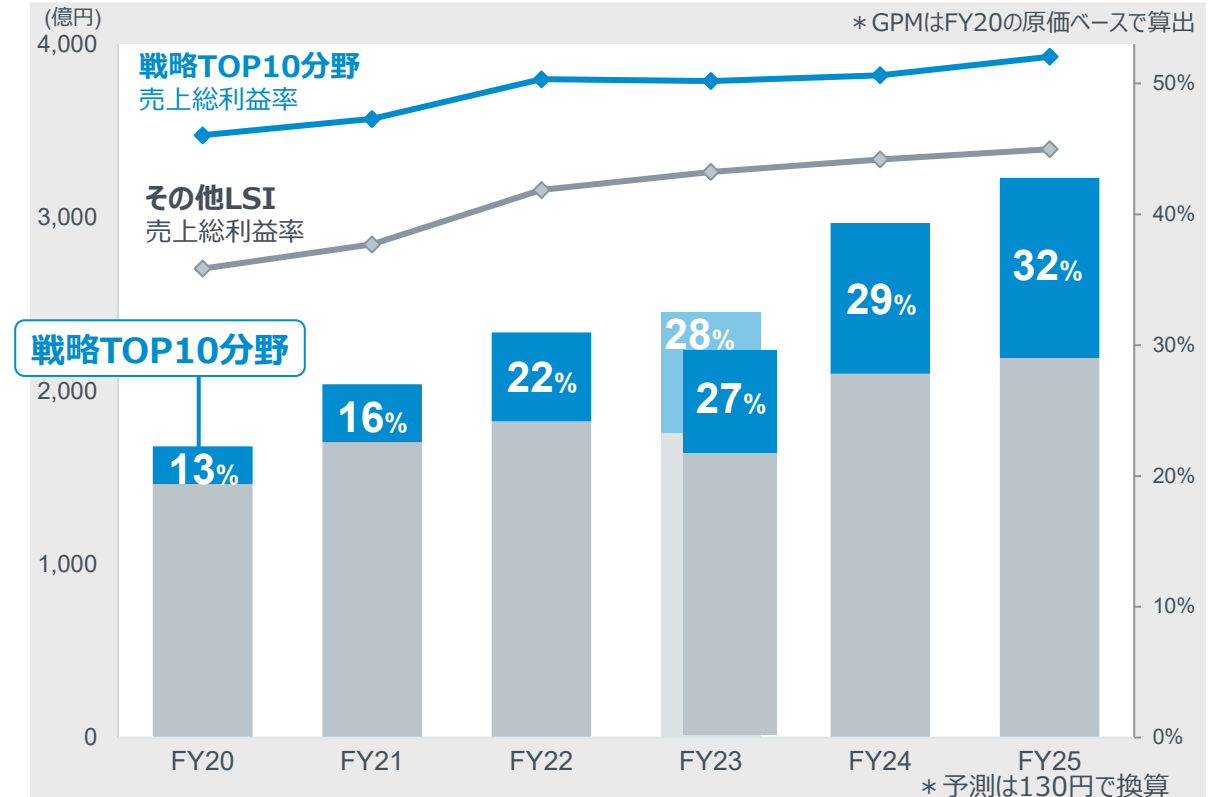
売上伸長・付加価値のあるASSP分野のTOP10を戦略TOP10分野とし、戦略TOP10分野の売上構成比を上げ、売上・利益拡大を図る。



ポートフォリオ（戦略TOP10分野）



売上比率・売上総利益率（戦略TOP10分野）



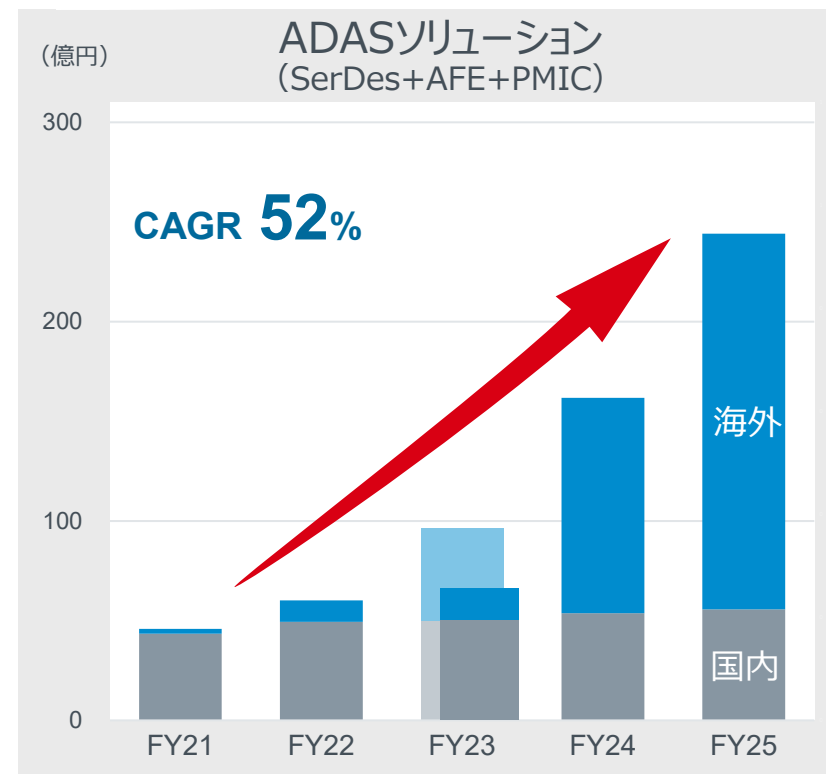
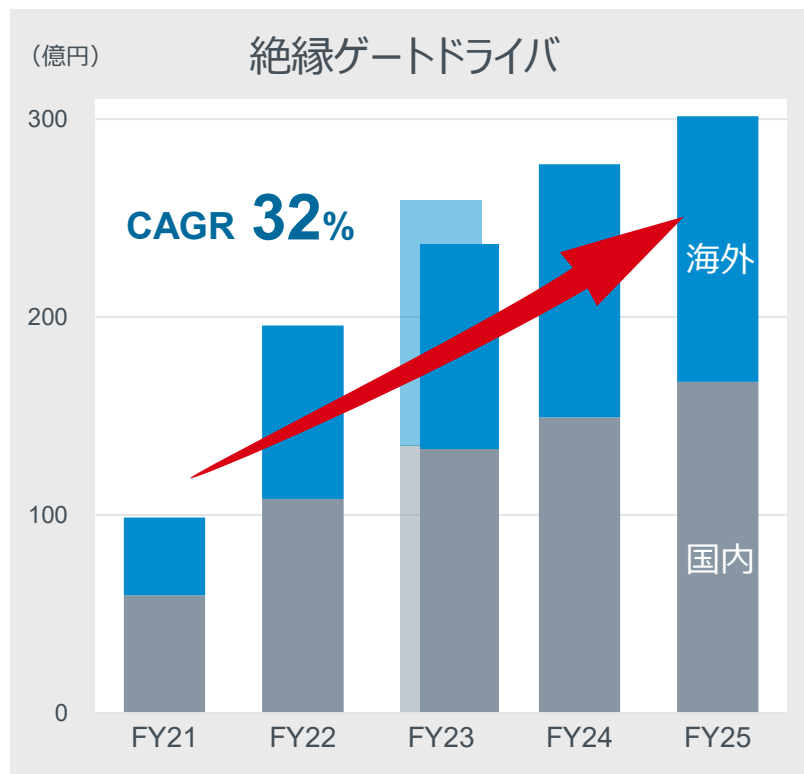
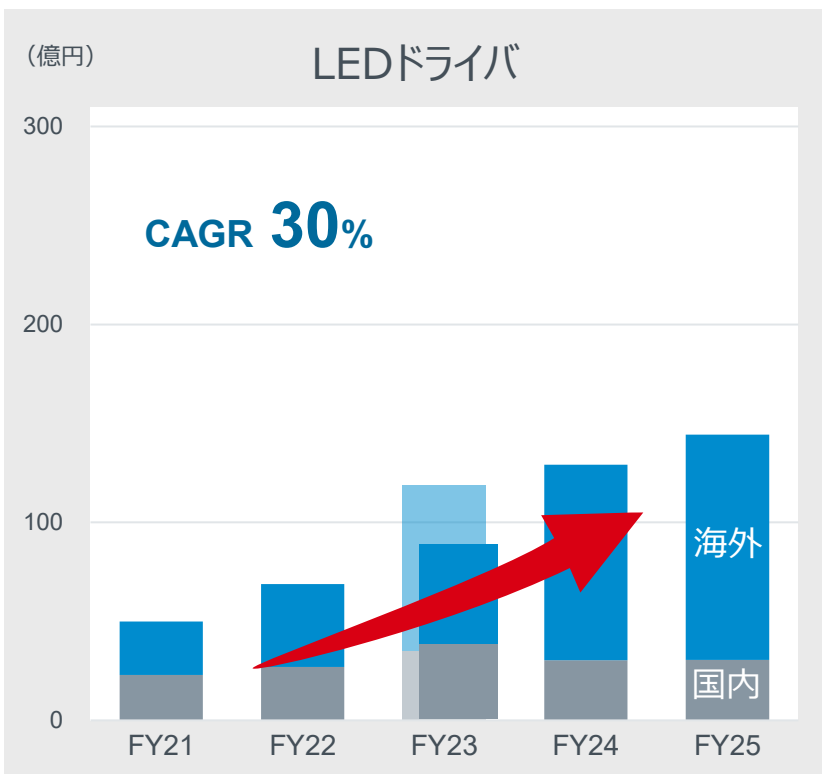
注力分野である車載向けソリューションで売上拡大

電装化・電動化の向上により、更なる成長が期待できる車載向け市場において、付加価値のある製品を継続して投入。

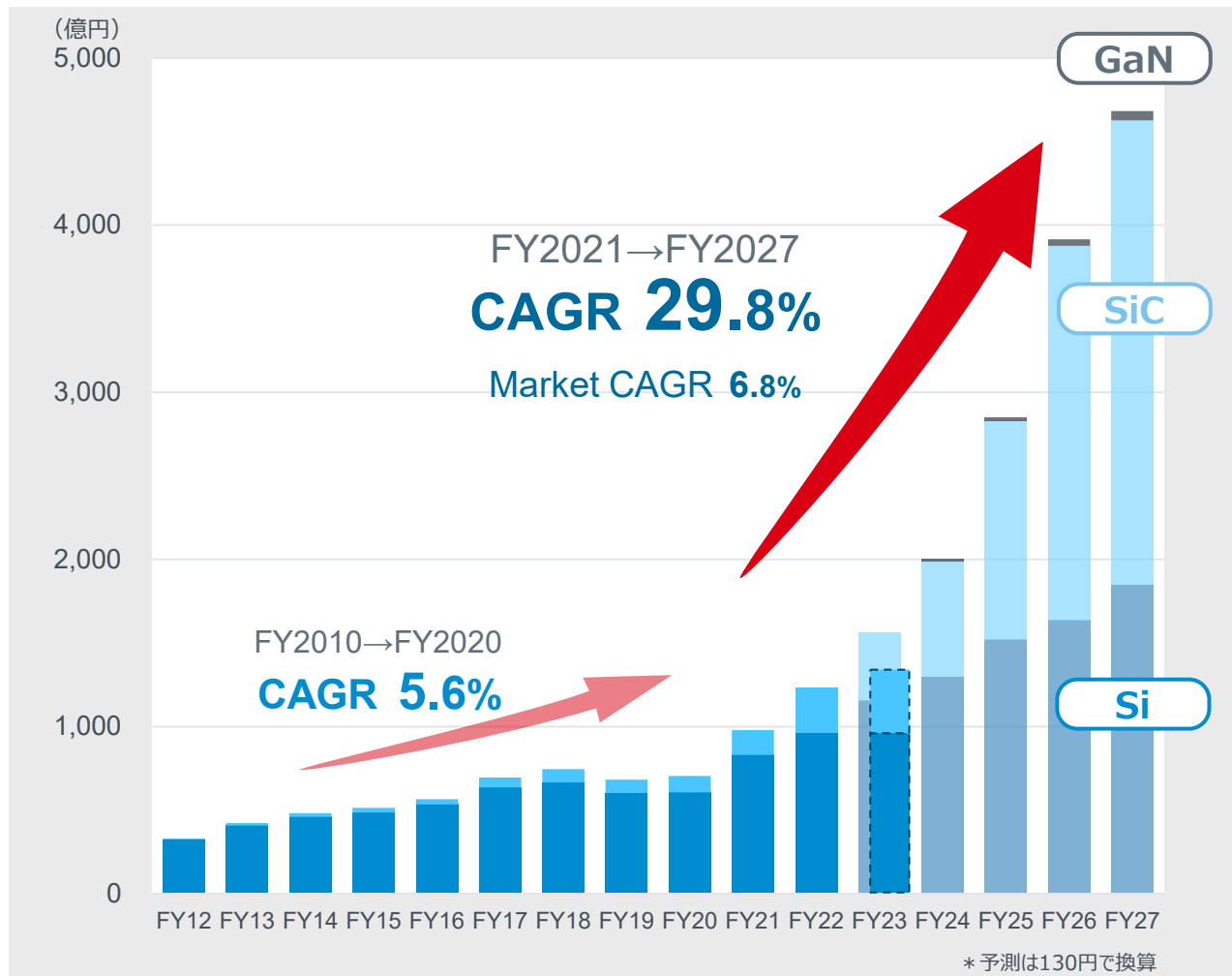
海外顧客向け売上を高め、車載全体の売上規模を拡大。



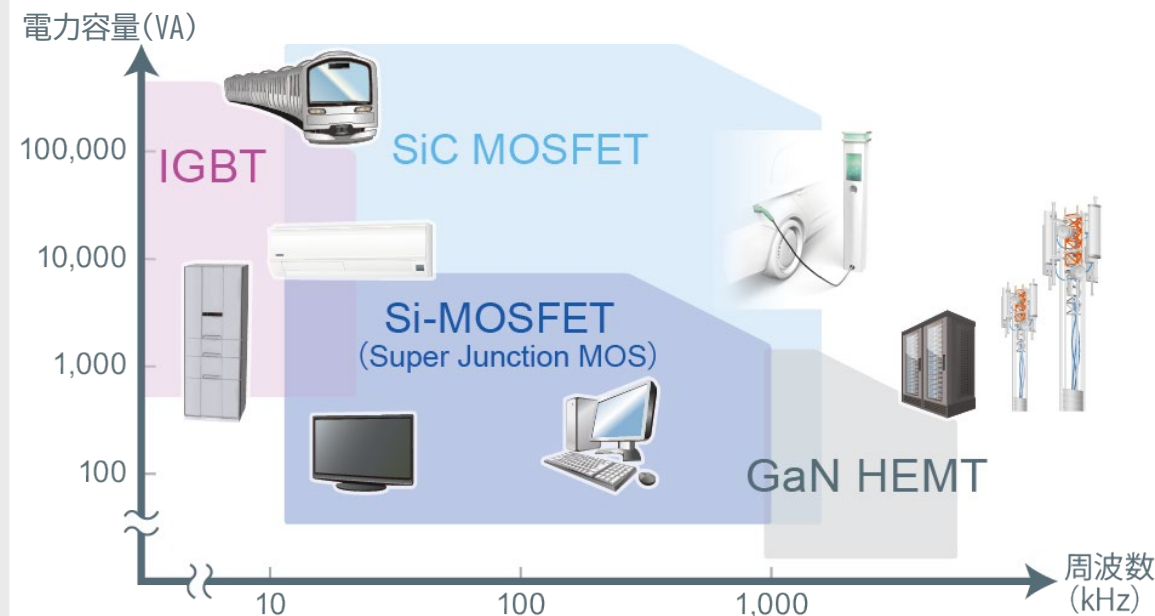
* 予測は130円で換算



パワーデバイス事業の売上目標



パワーデバイスのアプリケーション適用範囲



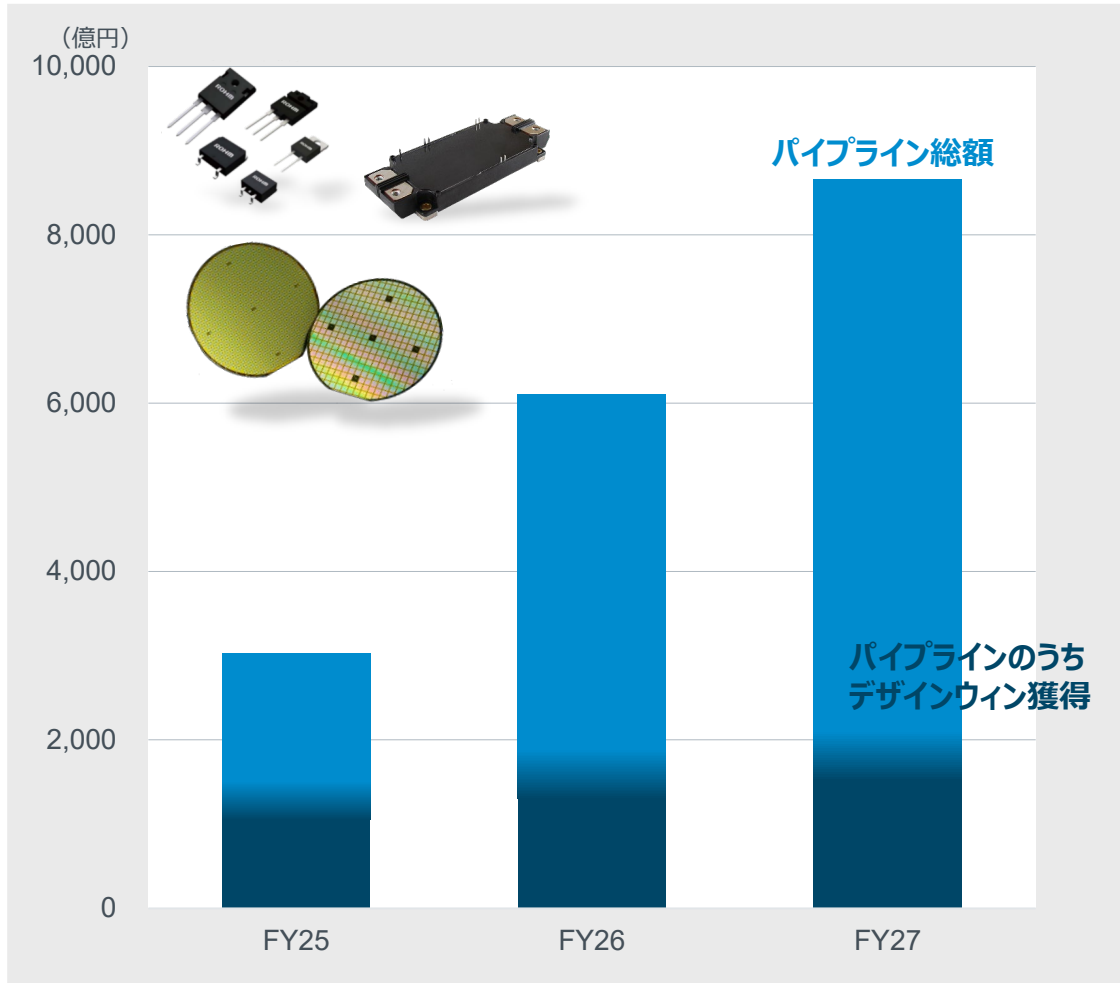
SiC

- 大電力
- 高電圧(> 600V)
- 高周波(20~200kHz)

GaN

- 中電力
- 中電圧(100~600V)
- 高周波(200kHz以上)

SiC事業のパイプライン（新規+既存）

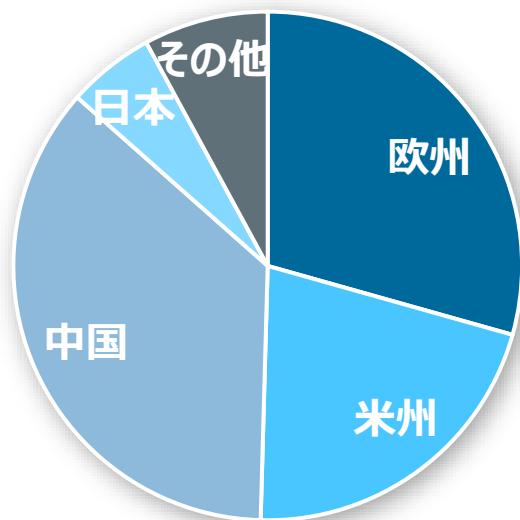


SiC事業の目標



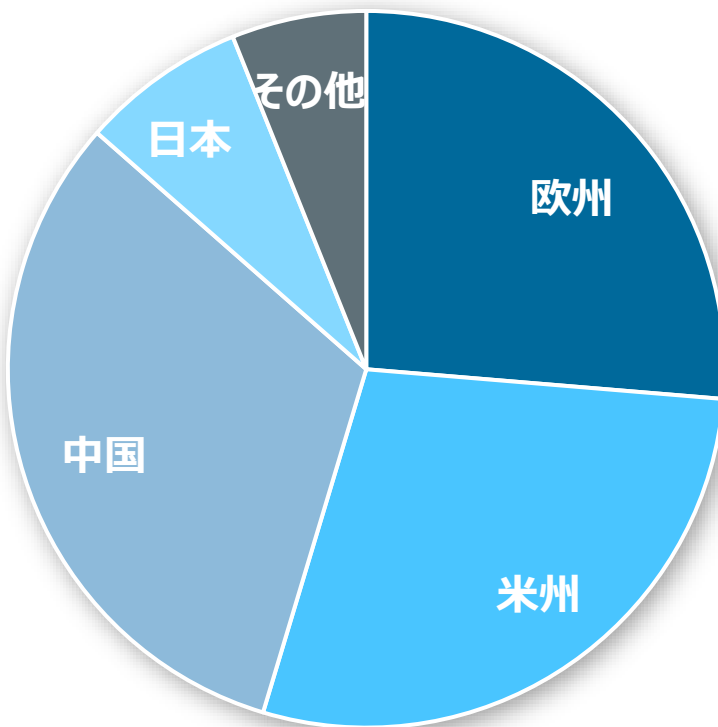
FY2025

3,000 億円



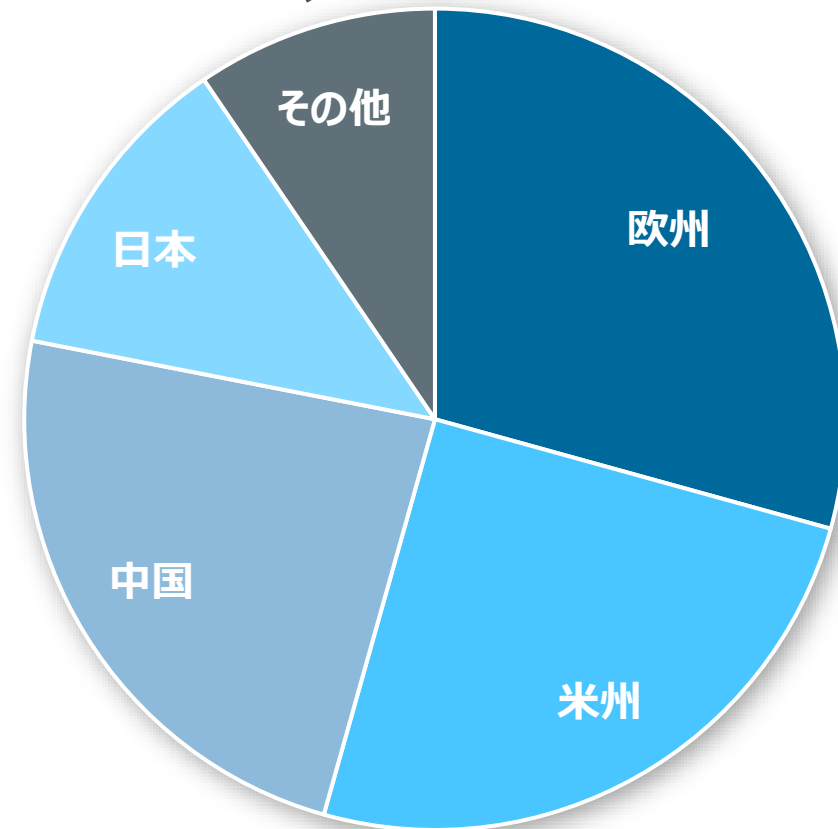
FY2026

6,000 億円

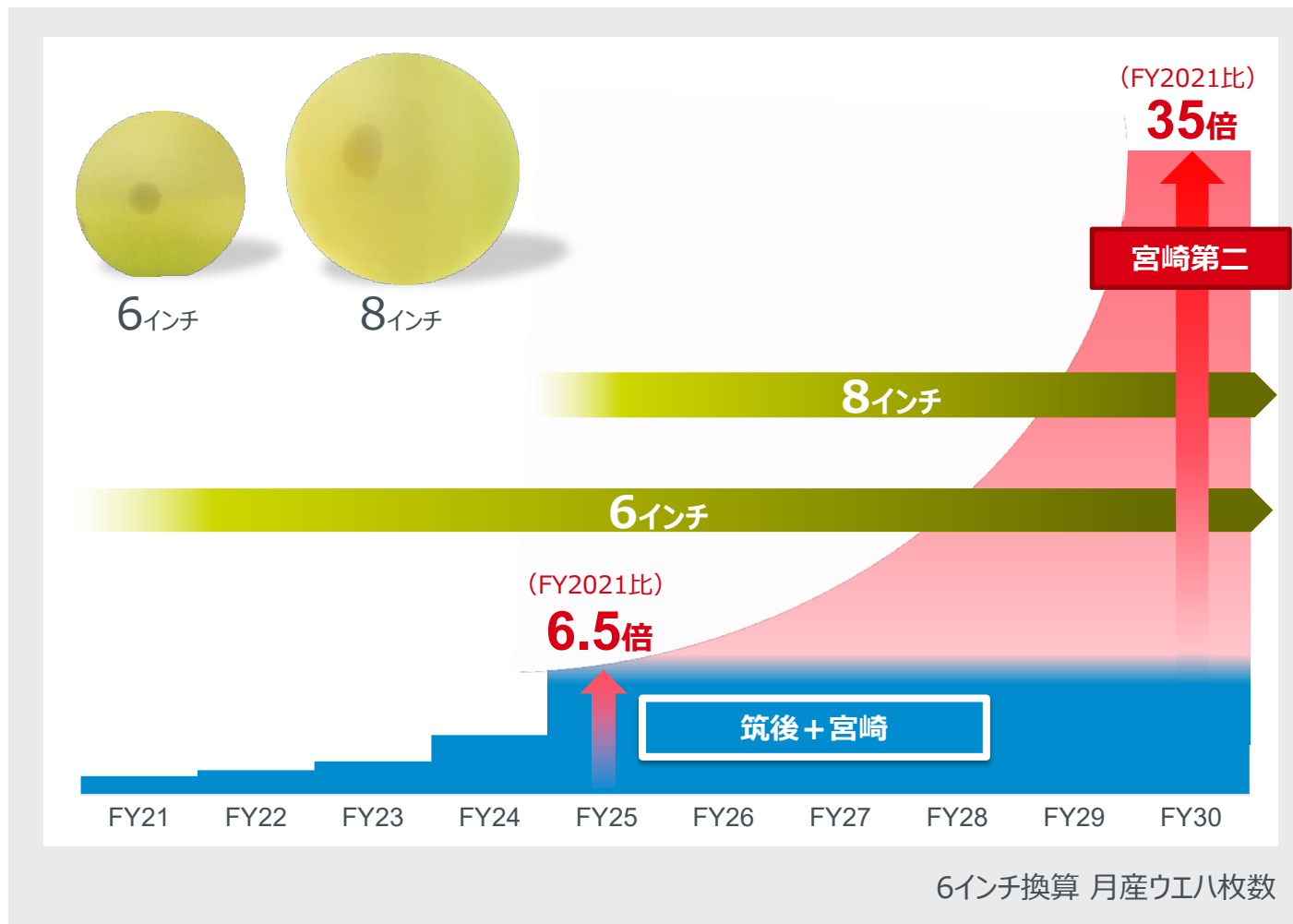


FY2027

8,500 億円



SiC事業のキャパシティ増強計画



宮崎第二工場 (国富)

NEW

新工場 8インチ

- ・2024年稼働予定
- ・SiCデバイスに加え、SiC基板も生産予定



宮崎工場

6インチ

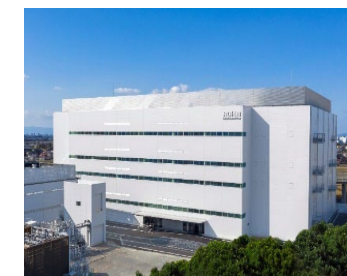
- ・2021年より第4世代SiC-MOSFETの量産開始



筑後工場

6インチ/8インチ

- ・8インチウエハへ変換可能な設備を導入
- ・新棟にて2022年12月より6インチ量産開始



出資形態

- ・LP出資 1,000億円
- ・優先株 2,000億円

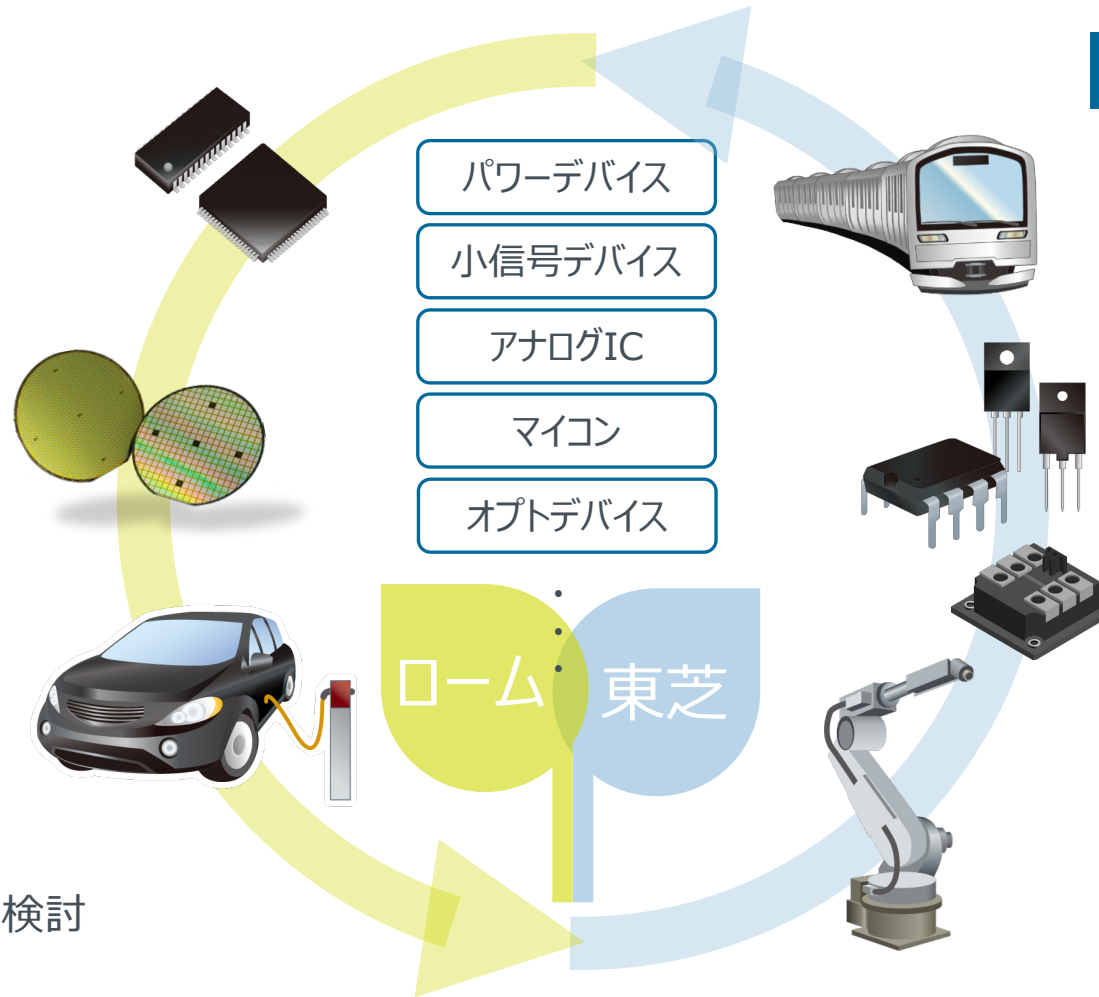
優先配当金利

- 発行日から3年経過まで：1%
- 3年経過後：20%
- 7.5年経過後：13%

財務計画

- ・金融機関5社によるブリッジローン3,000億円
- ・今後、1年を目途にパーマネントファイナンス実施予定

▶ 金融・資本市場を鑑みて慎重に検討



出資目的

- ・東芝の非公開化に参画し、同社が抱える課題の解消に協力
- ・JIPが組成する投資コンソーシアムの枠組みの下、東芝の企業価値を大きく向上させることができ得ると評価しており、相応のリターンを見込むことができる有意義な投資機会

**東芝の半導体事業は、当社との親和性が高く、
様々なシナジーを創出できる可能性もあり、非公開化後、具体的な協議を開始**

<ご注意事項>

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2023年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

<お問い合わせ先>

ローム株式会社 IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail : ir@rohm.co.jp



Electronics for the Future